

Hi-Density Buchsenleisten

Serie YFS

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com/YFS

Kontakträger:

Liquid Crystal Polymer, schwarz

Kontaktmaterial:

Phospher Bronze

Oberfläche:

Au über 50µ" (1,27 µm) Ni

Nennstrom:

2A bei 80°C

Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C

Übergangswiderstand:

10 mΩ max.

Betriebsspannung:

275 VAC mit YFT

Steckzyklen:

200 mit YFT

Verarbeitung:

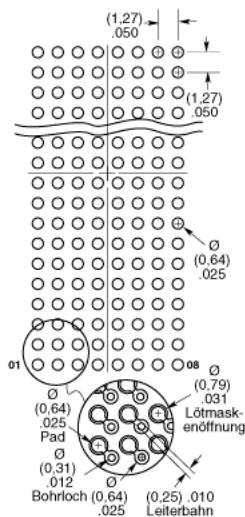
Löttemperatur (max.): 230°C/60 Sek.

Verarbeitungshinweise:

- Für wasserlösliche Lötspaste geeignet
- (0,15 mm) bis (0,20 mm) .006" bis .008" Lötspastenstärke
- 1:1 Lötmasken
- Verbindungslöcher entweder abdecken oder zustecken
- BGA Prozess
- Röntgeninspektion wenn erforderlich

Empfohlenes Platinen-Layout:

Gilt nur als Vorschlag. Für weitere Vorschläge zu Platinen-Layouts fragen Sie uns oder besuchen Sie uns unter www.samtec.com/YFS



Passend zu:
YFT, YFW



Hoch-zuverlässige
Tiger-Eye
Kontakte



(1,27 mm) .050"
Mikro-Raster

TEST ERGEBNIS

Bellcore-/ GR-1217-
CORE-/ "Four Gas MFG
Test" (Mixed Flowing Gas)
getestet. Besuchen
Sie uns unter <http://www.samtec.com/ftp/pub/testrpt/yfsyftqu.pdf>

Polarisierungsnase

Ebenfalls Lieferbar

RapidIO XMC Verbinder

- 6 x 19 Array
- 10 mm Stapelhöhe
- Nein solder balls
- Buchsenleiste: ASP-105884-01
- Stiftleiste: ASP-105885-01

Wenden Sie sich an
asp@samtec.com



Anwendungshinweise

Rapid I/O
Download unter
www.ateolappnote.com

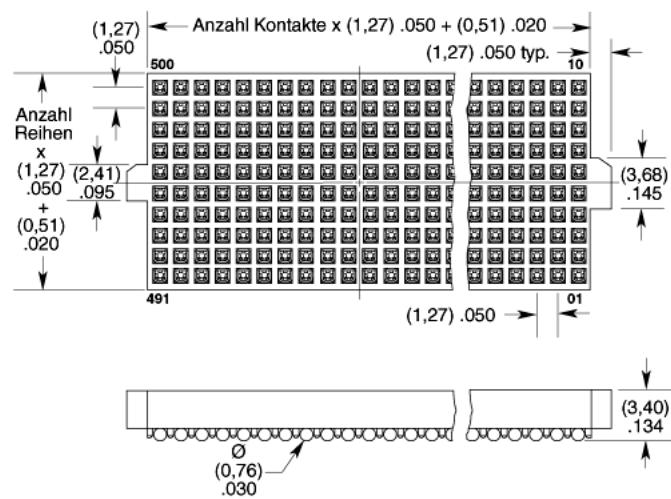
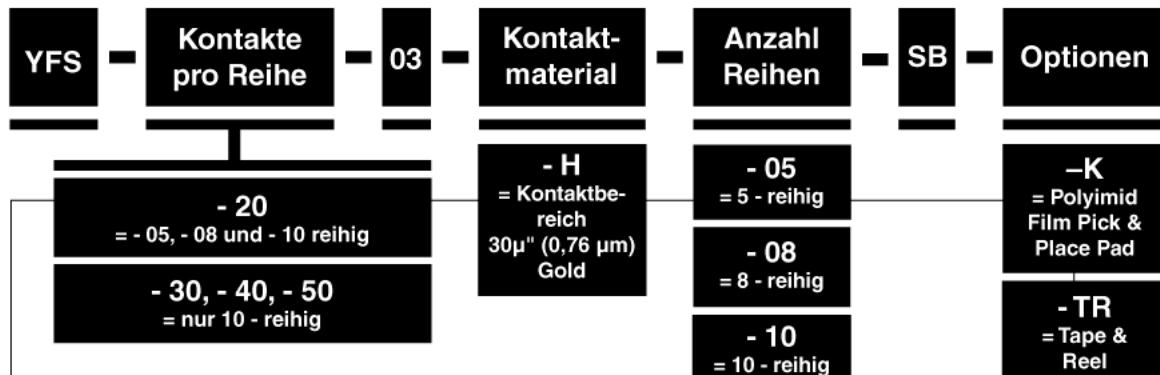
1,27 mm Raster YFS/YFT

Übertragung bei -3dB Eingangsdämpfung*

5 mm Stapelhöhe

Single-Ended Signal Routing	3.5 GHz / 7 Gbps
Differential Pair Signal Routing	9 GHz / 18 Gbps

*Daten basierend auf Simulationen mit Samtec's Final Inch® Kit



Anwendungsspezifische Optionen

30, 40, & 50 Kontakten mit
5 & 8 Reihen lieferbar.
Auch mit 3 & 6 Reihen lieferbar.
Fragen Sie uns.